#### 概述

RH-2500是用於印刷電路板銅表面上微 蝕液-有機酸系列之產品,可提昇密著 度。

#### 用途

- 1. 乾膜壓膜前處理。
- 2. 印刷防焊綠漆前處理。
- 3. 水性護銅處理前處理。
- 4. 噴錫前處理。
- 5. 壓合前處理。
- 6. 剥掛架剝銅處理。
- 7. 蝕薄銅線製程。
- 8. 化金前處理。
- 9. 化銀前處理。
- 10. 化錫前處理。

### 特性

- 1. 可得到潔淨粗糙的銅表面。
- 2. 咬蝕量穩定且易控制。
- 3. COD 少,廢水處理簡單。
- 4. 刺激性惡臭發生量少。
- 5. 使用噴灑式(SPRAY)。
- 6. 可適用化錫線處理前印刷防焊線 漆的前處理。

#### 物性

項目	外 觀	比 重		
RH-2500	無色~淡黃色 透明液體	1.111± 0.01(25℃)		
RH-2500C	青色透明液體	1.129± 0.05(25℃)		

### 使用方式

- 1. 建浴時請用RH-2500C,補充時請 使用 RH-2500。
- 2. 使用條件 噴灑(扇形噴灑2kg/cm2)(2L/ 分鐘)

温 度: 35~40℃接液時間: 30~90秒咬 蝕 量: 2μm/min

3. 處理後必須酸洗(3.5%HCL)來處 理板面後充分水洗及烘乾。

### 藥液補充方式

帶出量的添加 銅濃度在15g/L以下,補充RH-2500C銅濃度在15~30g/L,補充RH-2500銅濃度達到 30g/L以上,請參考濃縮 率後添加或排放藥水。



#### 藥液管理範圍

銅濃度 15 ~ 30g/L

#### 酸洗槽的管理

鹽酸濃度: 1~1.5 (mo1/L) 使用條件: 必需使用噴灑 壓 力: 0.5~1 kg/1

温 度: 室溫

接液時間: 10~20秒

### 測定比重(濃縮率)

以溫度35 ± 1℃ 來測定比重,再確認 槽內銅濃度之比重來計算濃縮率。

以下為銅濃度與比重的關係(35℃)

銅濃度	10	15	20	25	30	35	40
比重	1.113	1.119	1.127	1.132	1.137	1.144	1.153

#### 計算方式:

X%={(B-A)/[B\*(1-A)]}\*100 A=實際測量之比重

B=化驗銅濃度取得理論之比重

X= -10% 之外, 請全部換槽

X= -10% ~ +10%之間, 藥液可使用

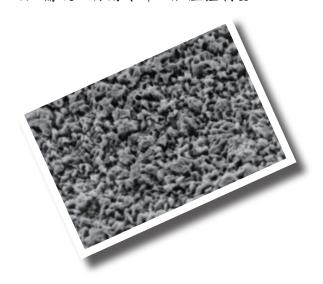
X= +10% ~ +20%之間, 加純水調整

### 注意事項

- 本藥液係醫藥用外劇毒物。 作業時請帶用手套、眼鏡等保護 器具,萬一藥液沾到皮膚或眼睛 時,馬上用水沖洗,然後接受醫 師的診療。
- 作業場所請設置排氣裝置,以保持舒適的作業環境。
- 3. 藥液的保管(包括使用後的廢液),請放存放在不受直射陽光照射的冷暗場所。
- 4. 藥液漏出時,請加水稀釋後以消石灰中和。

#### 設備

- 1. 使用此藥品之金屬部份要使鈦材質(不可以使用不銹鋼),塑膠部份則使用硬材質PVC、PP、PE。
- 2. 不可以使用浸泡來處理必設置排 氣管道。
- 3. 需設立自動冷卻、加溫控制器。



#### 計算方式

#### 銅濃度(W/W%)

#### 藥劑

- 1. 氨水
- 2. 0.4% (murexide)紫酸銨 0.2克
- 3. 0.1M EDTA.2Na

#### 步驟

- 1. 取 1 ml待測藥劑,置入 250 ml錐形瓶中。
- 2. 加入純水 100 ml。
- 3. 加入氨水於瓶中,至待測藥劑變成深藍色。
- 4. 加入0.4%的murexide,约0.2克。
- 5. 以0.1M EDTA. 2Na溶劑滴定,在溶液由紅黃色變成紫色時,即為滴定終點。
- 6. 記錄滴定量。

#### 判定

紅黃色至紫色

#### 銅濃度計算

銅濃度g/L= 6.354 × F × V V=0.1M EDTA.2Na 滴定量(m1) F=0.1M EDIT.2Na 校正系數

#### 微蝕量計算方式

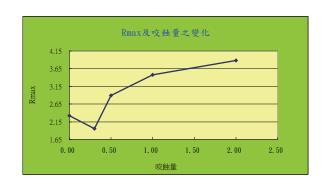


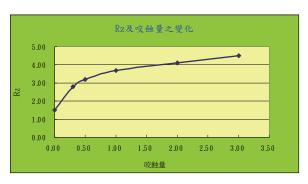
### 粗糙度測試

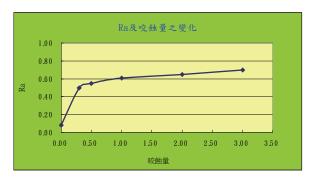
咬蝕量(μ៣)	0.00	0.30	0.50	1.00	2.00	3.00
$Ra(\mu m)$	0.08	0.50	0.55	0.61	0.65	0.70
$Rmax(\mu m)$	2.32	1.96	2.90	3.48	3.88	4.40
$Rz(\mu m)$	1.52	2.80	3.20	3.70	4.10	4.50
$RMS(\mu m)$	0.10	0.12	0.12	0.12	0.16	0.18
$Rt(\mu m)$	0.64	0.76	0.70	0.92	1.06	1.20
$Rtm(\mu m)$	0.50	0.60	0.58	0.78	0.94	1.02
$Sm(\mu m)$	460.00	321.00	376.00	142.00	122.00	92.70
$\theta$ a (deg)	1.52	1.81	1.83	2.97	2.99	3.21

Ra (中心線平均粗糙度):在測試範圍內,波峰與波谷之積分總和除以總長度 Rz (十點平均粗糙度):在測試範圍內,取五個峰值減去五個谷值平均

Rmax (最大粗糙度):在測試範圍內,最高波峰與最低波谷的和

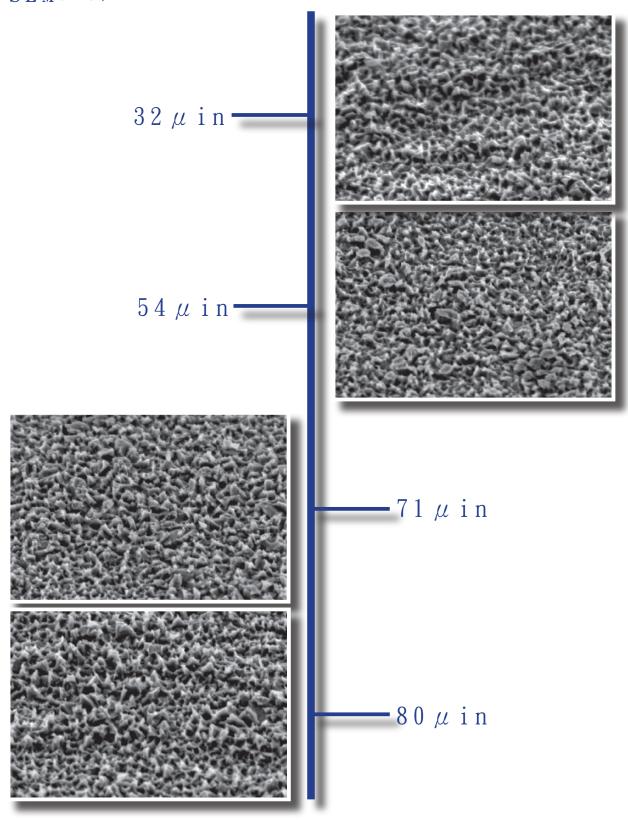








## SEM照片



## 操作時常見問題

狀況	原因	對策
發生銅結晶	銅濃度過高	依照產品對銅濃度的要求進行更換藥水
	水蒸發過多	將排氣管調整,依照分析加入純水
	溫度過低	液溫要保持 35~40℃之間(加熱器及冷卻管)
微蝕量過小	銅面基板不清潔	使用清潔劑後再進行微蝕
	溫度過低	處理溫度20℃以上
	噴嘴塞著(壓力無法調整)	清洗噴嘴
微蝕後發生氧化	阻液滾輪污染	清洗阻液滾輪
	水洗不良	清洗噴嘴
	水洗出不來	確認幫浦
	水洗水污染	更換水洗水
	水洗後進入烘乾時間過長	水洗後2分鐘以內要進入烘乾段
	烘乾不足	確認烘乾段加熱器、風刀、阻水滾輪有沒有乾燥
组	有油脂附著	先用清潔劑清洗後微蝕
銅面狀況不佳	滾輪類的痕跡	清洗滾輪,確認滾輪材質適不適當
溫度過高	冷卻水沒有流動	確認電磁閥,溫度感知器
	溫度設定不對	重新設定, 再調整
	冷卻管溫度過高	装冰水機產生冷水
溫度過低	加熱器斷線	確認加熱器回路電流値
	溫度設定不對	確認設定再調整
液面過低	槽底亀裂或漏液	修理槽體
	配管,幫浦異常	點檢幫手或管件
	沒有補充藥液	藥液的補充